

### 特点:

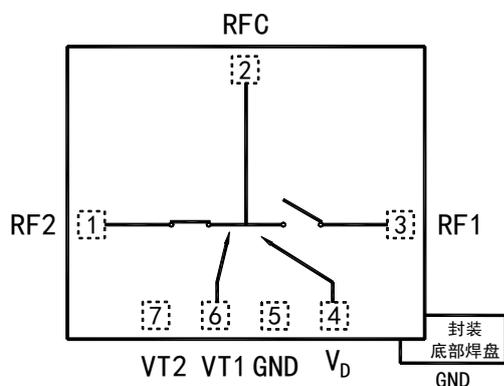
- 频率: 0.9~1.3GHz
- 损耗: 0.9dB
- 隔离度: 50dB
- 开关时间: 60ns
- 吸收式开关
- SMT 封装
- 尺寸: 6.6×5.5×1.5mm
- 执行标准为 GJB8481-2015

### 性能参数: (T<sub>A</sub>= -55~+85°C)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	Z <sub>IN</sub> =Z <sub>OUT</sub> =50Ω V <sub>D</sub> =+5V f=0.9~1.3GHz 控制电平: 0/+5V	0.9		1.3	GHz		
插入损耗	IL			0.9	1.4	dB		
输入驻波比	VSWR <sub>I</sub>			1.2:1	1.5:1			
输出驻波比	VSWR <sub>O</sub>			1.2:1	1.5:1			
隔离度	ISO			50		dB		
输入 1dB 压缩点	P <sub>-1</sub>			20		dBm		
开关时间 <sup>①</sup>	t				60	ns		
上升沿	t <sub>RISE</sub>			15	20	ns	10% RF~90% RF	
下降沿	t <sub>FALL</sub>			15	20	ns	90% RF~10% RF	
控制电平	V <sub>TH</sub>			4.5	5.0	5.5	V	
	V <sub>TL</sub>			0.0		+0.7	V	
电源电压	V <sub>D</sub>			4.75	5.00	5.25	V	
电源电流	I <sub>D</sub>					5	mA	
质量	m				1.0	g		

注: ①开关时间: 开通时间=50% Ctrl~90% RF, 关闭时间=50% Ctrl~10% RF。

### 功能框图:



### 引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1	RF2	射频输出端口 2, DC 耦合
2	RFC	射频输入端口, DC 耦合
3	RF1	射频输出端口 1, DC 耦合
4	V <sub>D</sub>	电源+5V
5	GND	接地
6	VT1	控制端 1
7	VT2	控制端 2
底部中央焊盘	GND	接地

### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+23 dBm
电源电压	+6.0 V
控制电压	+5.5 V
热阻	°C/W
沟道温度	150°C
工艺应用温度	260°C, 20s
工作温度	-55~+85°C
贮存温度	-55~+125°C
静电防护等级(HBM)	Class 1A

超过以上条件, 可能引起器件永久损坏。

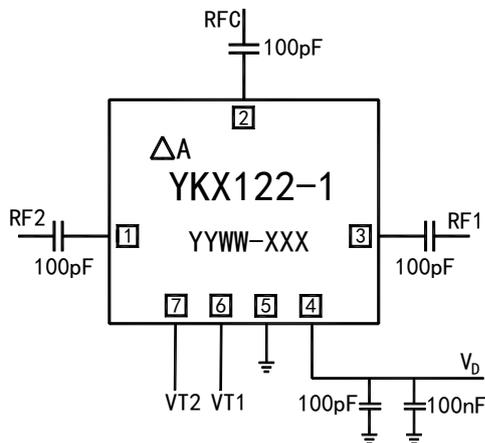
### 真值表: (0: 0V, 1: +5V)

控制输入		射频通路	
VT1	VT2	RFC-RF1	RFC-RF2
0	1	关断	导通
1	0	导通	关断

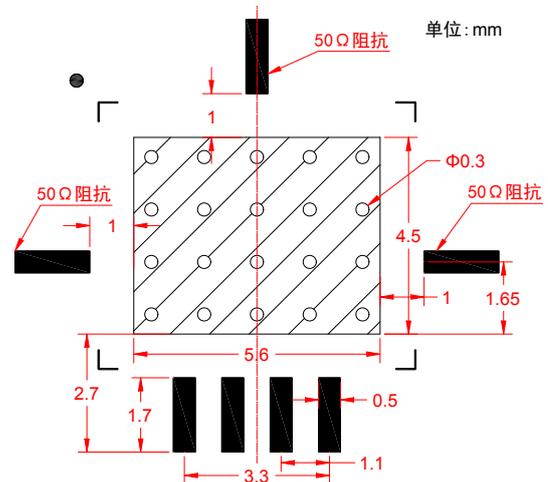
### 控制电流

状态	电压	电流(典型值)
Low	0~+0.8V	≤30μA
High	+3~+5.5V	≤500μA

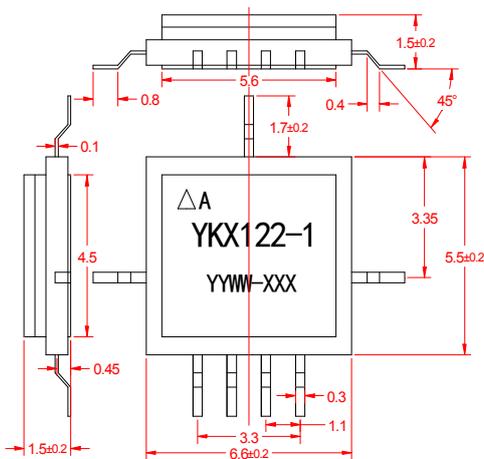
### 推荐外围电路:



### 推荐焊盘:



### 外形尺寸图:



注: 1、单位: mm, 未注明公差按±0.15mm;

2、产品采用气密陶瓷封装, 引脚表面镀镍金  
(Ni:1.2~8.9um, Au:1.2~5.7um);

3、产品标识采用激光刻字。

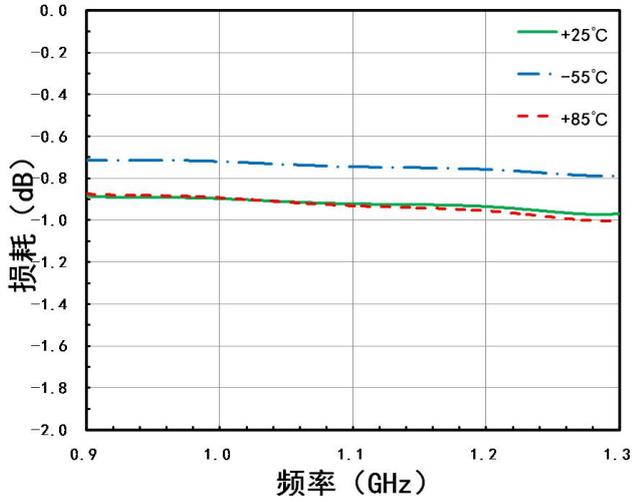
### 字符标志:

标识	说明	备注
YKX122-1	产品型号	
ΔA	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

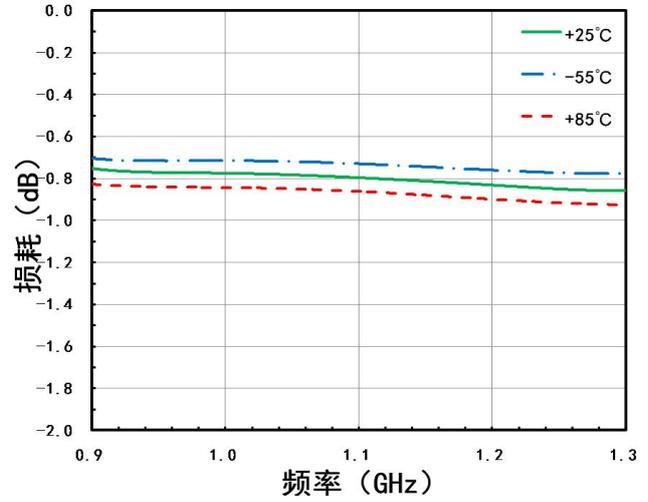


典型测试曲线:

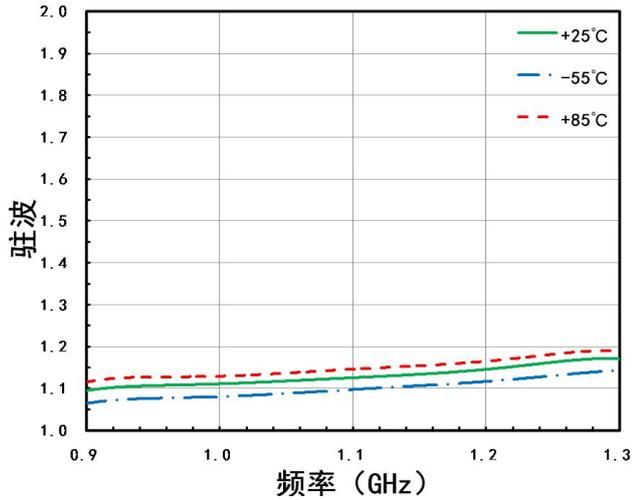
RFC→RF1损耗 VS. 温度



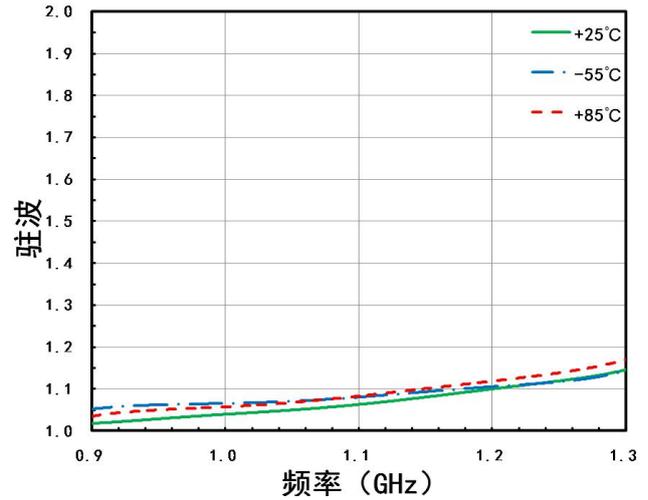
RFC→RF2损耗 VS. 温度

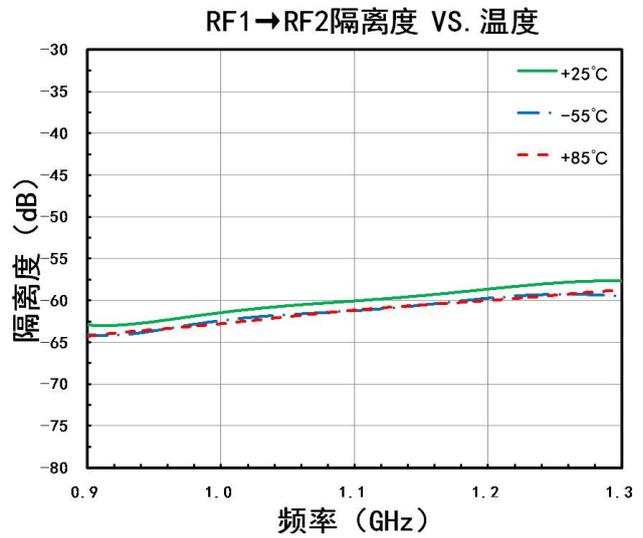
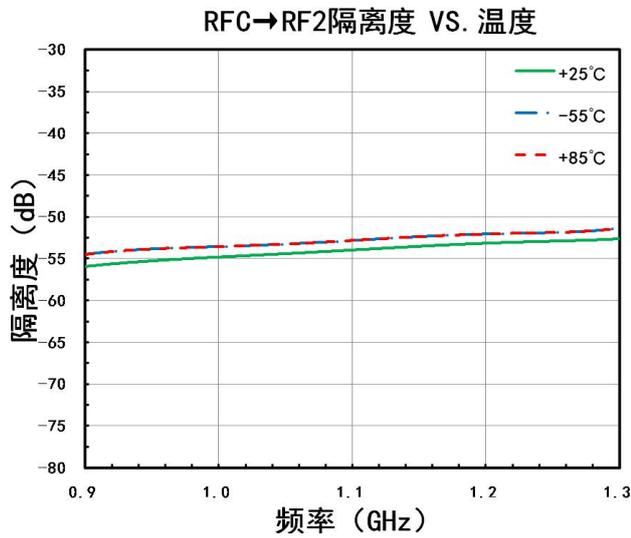
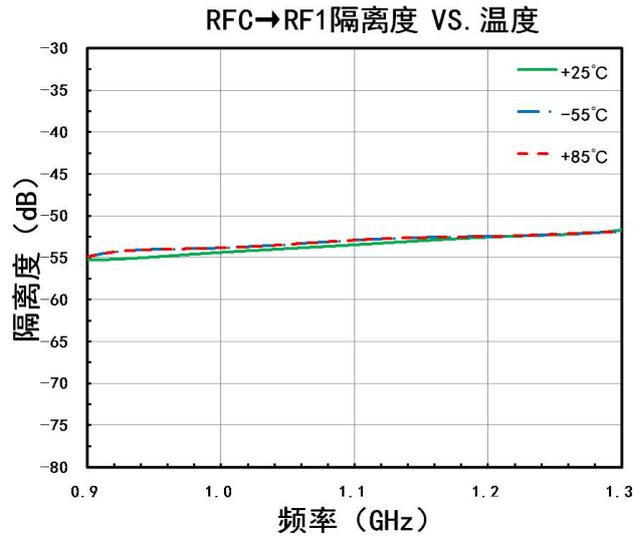
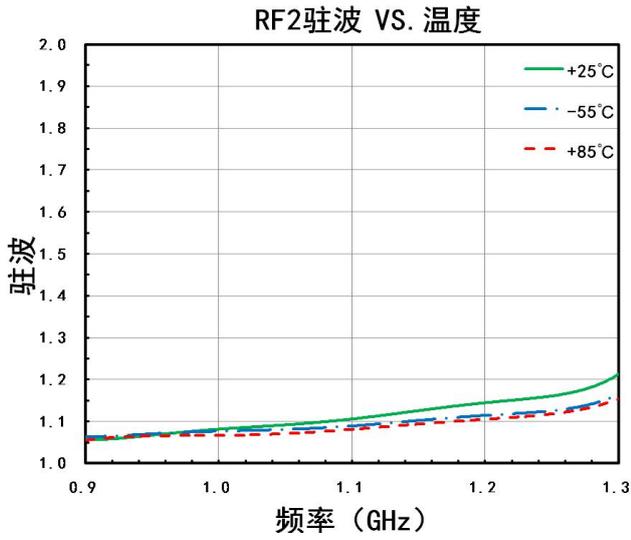


RFC驻波 VS. 温度



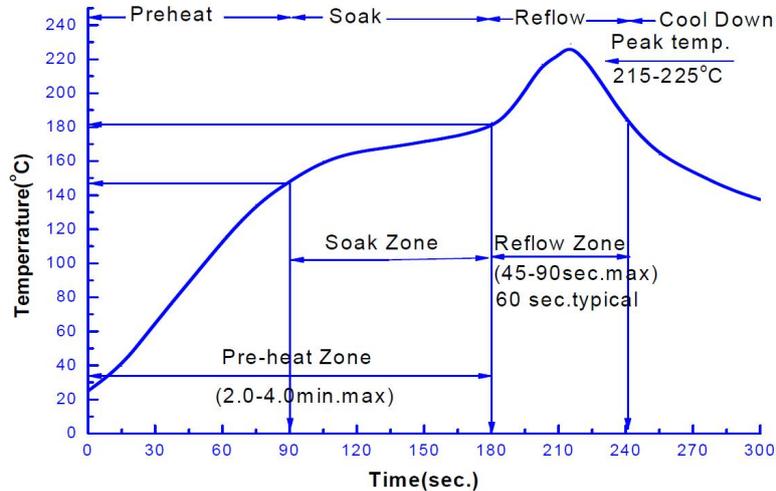
RF1驻波 VS. 温度





## 产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 对带有引出端的引脚，在产品运输、存储及使用过程中应注意对引出端引脚的防护，不允许对引脚进行再成型处理，防止引脚受外界应力影响而出现引脚折弯、开裂及脱落等现象。
7. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。